

# E DIN 50003:2023-08 (D)

Erscheinungsdatum: 2023-06-30

## Klebung in elektronischen Anwendungen - Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Materialien zur Wärmeableitung

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Auswahl eines geeigneten Verfahrens .....	5
5 Übersicht möglicher Verfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit.....	6
5.1 Übersicht.....	6
5.2 ISO 8301, Wärmeschutz; Bestimmung des stationären Wärmedurchlasswiderstandes und verwandter Eigenschaften; Verfahren mit dem Wärmestrommessplatten-Gerät .....	7
5.2.1 Kurzbeschreibung:.....	7
5.2.2 Vorteile der Methode .....	7
5.3 ISO 8302, Wärmeschutz; Bestimmung des stationären Wärmedurchlasswiderstandes und verwandter Eigenschaften; Verfahren mit dem Plattengerät .....	7
5.3.1 Kurzbeschreibung:.....	7
5.3.2 Vorteile der Methode .....	7
5.4 DIN EN ISO 22007-2, Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit — Teil 2: Transientes Flächenquellenverfahren (Hot-Disk-Verfahren) .....	7
5.4.1 Kurzbeschreibung:.....	7
5.4.2 Vorteile der Methode .....	7
5.5 DIN EN ISO 22007-4, Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit — Teil 4: Laserblitzverfahren.....	8
5.5.1 Kurzbeschreibung:.....	8
5.5.2 Vorteile der Methode .....	8
5.5.3 Weitere Hinweise:.....	8
5.6 ASTM D5470-17, Standard Test Method for Thermal Transmission Properties of thermally Conductive Electrical Insulation Materials.....	8
5.6.1 Kurzbeschreibung:.....	8
5.6.2 Vorteile der Methode .....	8
5.6.3 Weitere Hinweise:.....	9
6 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse .....	9
7 Prüfbericht .....	9
Literaturhinweise .....	10